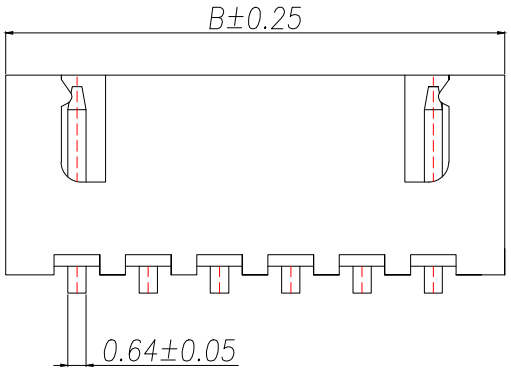
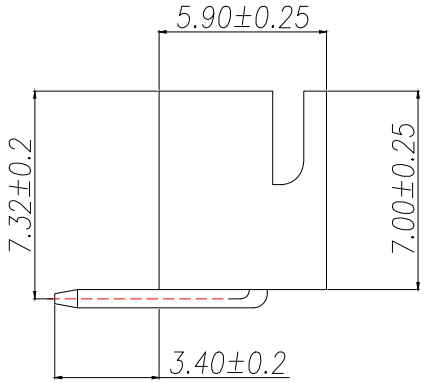
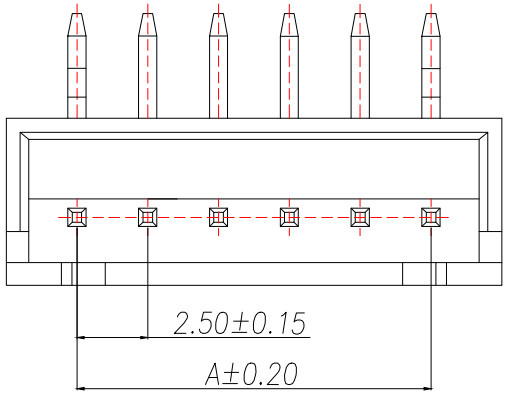
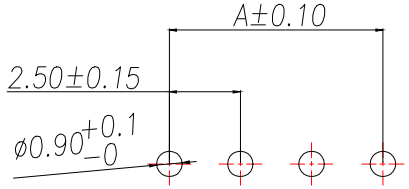








SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

Part No	Pin	A	B
XH2.5 −2PWZ	2	2.50	7.50
XH2.5 −3PWZ	3	5.00	10.00
XH2.5 −4PWZ	4	7.50	12.50
XH2.5 −5PWZ	5	10.00	15.00
XH2.5 −6PWZ	6	12.50	17.50
XH2.5 −7PWZ	7	15.00	20.00
XH2.5 −8PWZ	8	17.50	22.50
XH2.5 −9PWZ	9	20.00	25.00
XH2.5 −10PWZ	10	22.50	27.50
XH2.5 −11PWZ	11	25.00	30.00
XH2.5 −12PWZ	12	27.50	32.50
XH2.5 −13PWZ	13	30.00	35.00
XH2.5 −14PWZ	14	32.50	37.50
XH2.5 −15PWZ	15	35.00	40.00
XH2.5 −16PWZ	16	37.50	42.50
XH2.5 −17PWZ	17	40.00	45.00
XH2.5 −18PWZ	18	42.50	47.50
XH2.5 −19PWZ	19	45.00	50.00
XH2.54−20PWZ	20	47.50	52.50

技术要求:

1.塑件材料:PA66(UL−94V−0)

2.接触件:黄铜镀锡

3.接触电阻:≤10mΩ

4.绝缘电阻:≥100MΩ

5.额定电压:250V AC DC

6.额定电流:2.0A AC DC

7.耐压:能承受1000V AC/Minute

8.工作温度:−25°~+85°

9.可焊性试验:浸锡面积≥95%温度235°$^{+5}_{-0}$,时间2.5±0.5秒

10.铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求.

序号	名称	材料	数量	备注
2	端子Contact	黄铜	N*1	电镀(锡):整个表面镀底镍30u"MIN,再镀锡80u"MIN
1	基座Wafer	PA66(UL94V−0)	1	白色

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE	
.X±0.20	±2°
.XX±0.10	
.XXX±0.05	

制图 DRAWING	ROSE		
审核 CHECK	LEO		
核准 APPROVAL	JOHN		
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	BTC-XH2.5-N*AW	版本 REV.	A
品名 TITLE	WAFER XH2.54MM 直针	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

深圳市宝通成电子有限公司